

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年11月25日(25.11.2021)



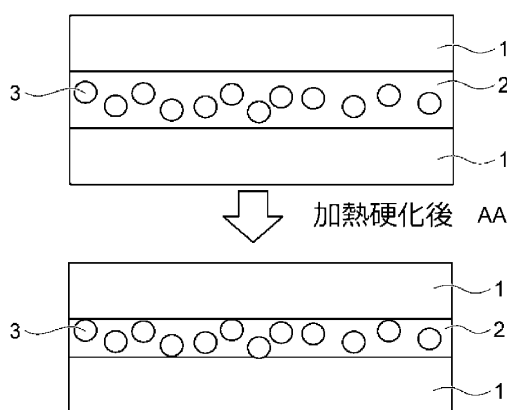
(10) 国際公開番号

WO 2021/235447 A1

- (51) 国際特許分類:
B22F 1/00 (2006.01) H01B 1/22 (2006.01)
B22F 7/04 (2006.01) B22F 3/10 (2006.01)
H01B 1/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/018843
- (22) 国際出願日: 2021年5月18日(18.05.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-087051 2020年5月18日(18.05.2020) JP
- (71) 出願人: 田中貴金属工業株式会社
(TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.) [JP/JP];
〒1006422 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 阿部 真太郎(ABE Shintaroh); 118259 キャベンディッシュ #04-07/08 サイエンスパークドライブ85 タナカキキンゾク (シンガポール) プライベートリミテッド内 Singapore (SG). 近藤 剛史(KONDO Takeshi); 〒2540021 神奈川県平塚市長瀬2-1-4 田中貴金属工業株式会社湘南工場内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: アインゼル・フェリックス＝ラインハルト, 外(EINSEL Felix-Reinhard et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) Title: CONDUCTIVE COMPOSITION, CONDUCTIVE SINTERED PART, AND MEMBER HAVING CONDUCTIVE SINTERED PART

(54) 発明の名称: 導電性組成物、導電性焼結部、および導電性焼結部を備えている部材



AA After heating and curing

(57) Abstract: The present invention relates to a conductive composition, and a member having a sintered part or a bonding part that uses the composition, and preferably to an electronic component, and more preferably to an electronic component for a vehicle or communication device. This conductive composition contains conductive fillers and resin particles, wherein a change rate of the maximum Feret diameter of the resin particles before and after sintering the conductive composition is less than 1.20. The conductive composition may contain, as the conductive fillers, (A) silver fine particles having an average particle diameter of 10-300 nm, and (B) metal particles having an average particle diameter of 0.5-10 μ m, and contain, as the resin particles, (C) resin particles having an average particle diameter of 2-15 μ m.

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：本発明は、導電性組成物および導電性組成物が用いられている焼結部もしくは接合部を備えている部材、好ましくは電子部品、さらに好ましくは車載用または通信機器用の電子部品に関する。導電性フィラーおよび樹脂粒子を含有する導電性組成物であって、前記導電性組成物を焼結する前後における前記樹脂粒子の最大フェレー径の変化率が、1.20未満である。前記導電性組成物は、前記導電性フィラーとして、（A）平均粒子径が10～300nmの銀微粒子、（B）平均粒子径が0.5～10 μ mの金属粒子を含有してよく、前記樹脂粒子として、（C）平均粒子径が2～15 μ mである樹脂粒子を含有していてもよい。